

АВТОМОБИЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОНИКА

А. Чистов. Состояние и развитие локализации в отечественной автоэлектронике № 10, с. 72

ВЫСТАВКИ И КОНФЕРЕНЦИИ

Ю. Ковалевский. Пленарная часть Российского форума «Микроэлектроника 2023». Часть 3 № 1, с. 38

Ю. Ковалевский. Формирование дорожной карты развития отечественной пассивной ЭКБ. Расширенное заседание экспертного совета консорциума «Пассивные электронные компоненты» № 1, с. 44

Р. Мангушева. Международная выставка ExpoElectronica 2024 – новые разделы, новые компании, новые возможности для участников и посетителей № 2, с. 48

Ю. Ковалевский. Применение робототехники и искусственного интеллекта на предприятиях ОПК. Заседание Секции по военно-промышленной политике и бюджету Экспертного совета при Комитете Совета Федерации по обороне и безопасности № 4, с. 30

Ю. Ковалевский. Применение российской ЭКБ и меры по кадровому обеспечению отрасли. Некоторые мероприятия деловой программы выставки ExpoElectronica 2024 № 5, с. 40

Е. Каспарова. Актуальные вопросы обеспечения электромагнитной совместимости. XIII Всероссийская научно-техническая конференция «ЭМС» № 6, с. 36

Е. Каспарова. Проблемы обеспечения электронной компонентной базы предприятий промышленности и пути их решения. XIII Всероссийская научно-техническая конференция «ЭКБ» № 9, с. 46

Ю. Ковалевский. Пленарные заседания Российского форума «Микроэлектроника 2024». Часть 2 № 10, с. 36

Р. Мангушева, А. Большаков, Н. Мисниченко. Позитивные тренды и динамика развития электроники в России... № 10, с. 42

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА

С. Назаров, А. Дубровский. Использование искусственных нейронных сетей для управления вычислительными процессами № 4, с. 136

ИНФОРМАЦИОННЫЕ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ

Е. Старовойтов, Е. Скиба. Навигация в медицинских учреждениях: современные технологии № 1, с. 124

Н. Калиновский. Применение систем компьютерного зрения в беспилотных летательных аппаратах: новые возможности для робототехники № 3, с. 108

А. Шупов. Системы компьютерного зрения на промышленных предприятиях № 3, с. 112

М. Макушин. Аспекты развития 6G-сетей. Часть 1 № 5, с. 122

Е. Старовойтов, Е. Скиба. Непрерывная навигация внутри и снаружи помещений для роботизированной логистики... № 5, с. 132

М. Калашникова. Модель потенциальной радоноопасности территории. Использование метода kriging и Global Positioning System № 6, с. 104

Е. Старовойтов, Е. Скиба. Непрерывная навигация персонала внутри и снаружи помещений № 6, с. 108

М. Макушин. Аспекты развития 6G-сетей. Часть 2 № 6, с. 116

Е. Старовойтов, Е. Скиба, И. Синильщиков, А. Алпатов. Синхронизация базовых станций в комплексированной навигационно-связной системе «КОНСУЛ-Р» № 7, с. 100

И. Чикваркин. НИИМА «Прогресс»: беспроводная связь и навигационные решения для различных устройств – обмен данными, навигация и связь. Часть 1 № 9, с. 80

И. Чикваркин. НИИМА «Прогресс»: беспроводная связь и навигационные решения для различных устройств – обмен данными, навигация и связь. Часть 2 № 10, с. 122

Е. Старовойтов, Е. Скиба. Лазерные локационные системы 3D Flash Ladar для интеллектуальной навигации транспорта № 10, с. 126

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ

О. Чупринова. Идентификация показаний аналоговых измерительных приборов с помощью нейронных сетей № 6, с. 98

М. Макушин. Искусственный интеллект: новые архитектуры ИИ процессоров и расширение роли в проектировании ИС № 10, с. 138

ИСТОРИЯ УСПЕХА

Сила сотрудничества: оборудование, рожденное в тандеме производителя и заказчика № 3, с. 80

КОЛОНКА ДЕПАРТАМЕНТА РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

№ 1, с. 27, № 2, с. 29, № 3, с. 55, № 4, с. 21, № 5, с. 23, № 6, с. 25, № 7, с. 47, № 8, с. 31, № 9 с. 25

КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ

А. Завалко. Концепция SMART: как строить производства мирового уровня в России № 1, с. 12

И. Фоменко. Технологические преимущества дают нам возможность уверенно двигаться вперед № 1, с. 22

А. Аветисян. Сейчас идеальное время для создания производств в России № 2, с. 14

П. Куцко. В текущих условиях нужно постоянно быть в тонусе № 2, с. 22

З. Кондрашов. В современном мире навигация и связь будут непреложными факторами технологического преимущества и независимости страны № 3, с. 16

М. Гурбашков. Ключевая задача для индустрии робототехники – выстраивание тесной кооперации № 3, с. 24

А. Сизиков, Д. Махин. Новые продукты позволяют повысить нашу конкурентоспособность на гражданском рынке № 3, с. 32

Е. Липкин, О. Гогин. FLEX полтора года спустя: практика подтверждает востребованность решений для оперативного построения сбалансированных производств № 3, с. 36

С. Ульянов. Новый уровень производства – это не только его расширение, но и существенный рост качества продукции № 3, с. 44

А. Дедюхин. Мы успешно прошли тяжелый период благодаря диверсификации поставок № 3, с. 50

О. Машинин. Одно из приоритетных направлений для нас – расширение присутствия на гражданском рынке № 4, с. 12

А. Нарбутт. В приоритете – расширение спектра решений, развитие производства и, конечно, подготовка кадров № 5, с. 14

А. Верецкий. От технологического аудита к стратегическому партнерству № 6, с. 14

З. Кондрашов. Динамика роста форума «Микроэлектроника» отражает развитие электронной отрасли в стране № 7, с. 18

А. Алексеев. Тренды и проблемы развития отечественного электронного машиностроения № 7, с. 22

И. Крупенин. Мы хотим, чтобы заказчик видел в нас стратегического партнера № 7, с. 26

К. Конурин. Серийное сборочное производство электроники с нуля № 7, с. 30

Н. Шкрабляк. Опыт применения микроконтроллера от АО «НИИЭТ» в приборах учета электроэнергии № 7, с. 36

К. Ипполитов. Стремиться в будущее, извлекая уроки из прошлого № 7, с. 40

К. Пыденков. Санкции как импульс для модернизации производства № 7, с. 44

А. Дронов. Мы восстанавливаем систему подготовки уникальных специалистов, в которых остро нуждается электронная отрасль № 8, с. 12

Р. Юсупов. Доверенность начинается с ЭКБ № 8, с. 20

А. Панков. В России есть решения для искусственного интеллекта, не уступающие мировым № 8, с. 26

В. Смирнова. Наше ключевое достижение – портфель успешно реализованных проектов с реальным результатом для членов ассоциации № 9, с. 12

М. Вакштейн. Форум «Микроэлектроника 2024» – уникальная площадка, объединившая ключевых представителей науки, бизнеса, производств и органов государственной власти № 9, с. 20

А. Григорьева. Сейчас время производить! Как развивается разработчик отечественных материалов и оборудования для производства печатных плат № 10, с. 14

А. Кравцов. АО «НИИМЭ» – 60 лет лидерства в отечественной электронике № 10, с. 22

КОНСТРУКТОРСКИЕ РЕШЕНИЯ

А. Фединцева. Применение электроизоляционной термостойкой ленты ЛЭТСАР при изготовлении кабельных жгутов № 1, с. 100

Д. Ционенко, И. Козловский. Методика для расчета коэффициента теплопроводности композиционных материалов № 2, с. 62

Е. Абашин, С. Алехин, А. Гаврилин, О. Данцев. Современные тенденции корпусирования безвыводных металлополимерных корпусов № 3, с. 136

В. Шаломанов, Д. Баканин. Высокоскоростные дифференциальные пары на печатной плате для модульного соединителя № 3, с. 142

Ш. Шугаев, Е. Ермолаев, В. Егошин, А. Глунцов. Металлокерамические корпуса АО «ЗПП» для ВЧ- и СВЧ-приборов № 4, с. 86

Ш. Шугаев, Е. Ермолаев, В. Егошин, А. Глунцов, А. Лоскутова. Инновация АО «ЗПП»: металлокерамический корпус с J-выводами № 9, с. 68

В. Иванов, Д. Суханов. Тенденции корпусирования и сборки дискретных силовых элементов на базе полевых МОП-транзисторов № 10, с. 154

КОНТРОЛЬ И ИЗМЕРЕНИЯ

И. Гусев, В. Файзуллаев. Испытания на электромагнитную совместимость № 2, с. 118

К. Епифанцев. Статистический анализ влияния временных интервалов на результат измерения усилия на щупе кругломера RoundTest RA-120P № 2, с. 120

К. Епифанцев. Возможность применения бесконтактных датчиков для измерения дефектов формы № 2, с. 126

Н. Лемешко, М. Горелкин. Формирование и исследование сигналов с амплитудно-частотной модуляцией с помощью приборов компании Rigol № 2, с. 136

В. Поздеев, Ш. Шугаев, Е. Ермолаев, В. Егошин. Искусственный интеллект как средство совершенствования производственного процесса в АО «ЗПП» № 3, с. 196

С. Заостровных, В. Губа, А. Пивак. Измерение коэффициента шума № 4, с. 92

Н. Лемешко, М. Горелкин. Измерения помех, формируемых двигателями постоянного тока, с помощью приборов компании Rigol. Часть 1 № 4, с. 104

К. Епифанцев. Мультисенсорная кластерная сканирующая система кругломеров № 4, с. 114

А. Зайцев. Параллельный импорт и санкционные риски: как избежать нашествия «франкенштейнов» № 5, с. 138

Н. Лемешко, М. Горелкин. Измерения помех, формируемых двигателями постоянного тока, с помощью приборов компании Rigol. Часть 2 № 5, с. 144

К. Епифанцев. Исследование лазерных сканирующих систем для измерения дефектов формы № 5, с. 154

Д. Филиппов, А. Бакулин, А. Завгородний, М. Афанасьев. Оценка погрешности измерений группового времени запаздывания при помощи рефлектометра № 7, с. 120

К. Епифанцев, О. Заякин, Е. Фролова.

Метод измерения дефектов формы лазерными сканирующими системами № 7, с. 130

Е. Старовойтов, Е. Скиба, В. Руссанов. Использование оптических датчиков для взаимного позиционирования антенн при испытаниях радиосистем № 8, с. 56

Н. Лемешко, А. Агуреев. Динамический диапазон анализаторов спектра: особенности оценки и учета при измерениях. Часть 1 № 8, с. 60

А. Алонцев. Методика проведения входного контроля микросхем в металлокерамических корпусах № 8, с. 68

Н. Лемешко, М. Горелкин. Особенности применения многоканальных генераторов сигналов на примере приборов Nosean серии MSG5000. Часть 1 № 9, с. 104

К. Епифанцев. Сравнительный анализ зависимости точности измерений на контурографе от угловых и скоростных параметров щупа № 9, с. 116

Н. Лемешко, М. Горелкин. Особенности применения многоканальных генераторов сигналов на примере приборов Nosean серии MSG5000. Часть 2 № 10, с. 98

Н. Лемешко, А. Агуреев, Т. Плешкова. Динамический диапазон анализаторов спектра: особенности оценки и учета при измерениях. Часть 2 № 10, с. 108

М. Калашникова. Экологическое значение и основные задачи исследования потенциальной радоноопасности территории № 10, с. 120

МИКРО- И НАНОСТРУКТУРЫ

Д. Пермяков, А. Строгонов, В. Небольсин, М. Белых. Реверсивный рост пиролитических пленок ZnO № 8, с. 108

М. Макушин. EUV-литография: что ожидается в 2025 году? № 8, с. 112

МИКРОМОДУЛИ И МИКРОБЛОКИ

Д. Суханов. Последние достижения при создании чиплетов с использованием мостовых межсоединений № 9, с. 88

МИКРОПРОЦЕССОРЫ И ПЛИС

Д. Садеков. Микроконтроллеры и флеш-память от компании GigaDevice № 4, с. 126

А.В. Строгонов, О. Бордюжа, А.И. Строгонов. Международный опыт разработки процессорных ядер RISC-V и программные инструменты с открытым кодом для их проектирования № 7, с. 156

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ

Применение отечественной пассивной ЭКБ в автомобильной промышленности № 5, с. 32

НАДЕЖНОСТЬ И ИСПЫТАНИЯ

П. Алейников. Технология рентгеновского контроля № 2, с. 80

Р. Ермилов, Ш. Шугаев, Е. Ермолаев, В. Егошин.

Повышение характеристик надежности многовыводных металлокерамических корпусов АО «ЗПП» за счет применения систем тестового контроля № 2, с. 84

А. Строгонов. Методы прогнозирования долговечности ИС по параметрическим отказам № 2, с. 88

А. Дудунов. Использование ЭКБ с истекшим сроком хранения № 4, с. 146

Д. Селин. Основные механизмы воздействия специальных факторов на полупроводниковую структуру № 6, с. 42

Ш. Шугаев, В. Егошин, Е. Ермолаев, Д. Тайков. Применение прецизионных методов для электрического контроля металлокерамических корпусов № 8, с. 70

К. Кремлев. Актуальные методы контроля качества при проведении монтажа электронных компонентов № 8, с. 74

А. Козюков, М. Кожухов, Г. Протопопов, Д. Казанцев. Особенности проведения оценки соответствия ЭКБ, РЭА и материалов с использованием расчетных методов № 8, с. 80

Р. Валиев. Как выбрать климатическую камеру № 8, с. 82

П. Варламов, В. Леяев. Акустическая микроскопия: выявление скрытых дефектов № 10, с. 164

К. Епифанцев. Обзор отечественных инновационных методов производства приборов для контроля дефектов формы и профиля № 10, с. 168

К. Епифанцев, О. Куркова. Автоматизация и калибровка мультиплексной системы датчиков измерения дефектов формы № 10, с. 174

НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

Ю. Ковалевский. Совершенствование законодательства в области ценообразования на продукцию, поставляемую по ГОЗ. Заседание Секции по военно-промышленной политике и бюджету Экспертного совета при Комитете Совета Федерации по обороне и безопасности № 2, с. 54

Совершенствование механизмов реализации научно-исследовательских работ, направленных на создание передовых образцов ВВСТ. Совещание Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности № 8, с. 48

ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВОМ

А. Хисамов, А. Назаренко. Минифабы в микроэлектронике: история и возможности № 1, с. 64

А. Фединцева. Новый цех под «старые» жгуты: особенности автоматизации производства под литерную КД № 3, с. 208

А. Усатов, П. Ляхов. Как создать чистое производственное помещение. Технологии и оборудование № 3, с. 216

Е. Липкин. Создание производств мирового уровня в России: первоочередные задачи, проблемы, перспективы № 6, с. 64

О. Комарова. Контрактное производство в России сегодня: взгляд изнутри № 6, с. 68

ПОДГОТОВКА КАДРОВ

- Ю. Ковалевский.** Кадры в области СВЧ-измерений: потребности и пути их обеспечения. Часть 2..... № 1, с. 52
- Е. Янов, О. Маркарова.** Инженеров нового поколения готовят в ТулГУ..... № 8, с. 54
- Т. Крупкина, М. Кульпинов, В. Лосев, М. Путря, Ю. Чаплыгин, А. Балашов.** Профессиональный стандарт в области фотоники как инструмент обеспечения отрасли высококвалифицированными кадрами..... № 10, с. 180

ПОРТРЕТ ФИРМЫ

- Б. Трубачёв.** SETsafe|SETfuse: 24 года разработки и производства компонентов защиты электрических цепей..... № 2, с. 58
- С. Смирновский, Ю. Анджановская.** Электронные компоненты АО «Завод «Реконд»..... № 3, с. 100
- А. Маслов.** Широкий спектр оборудования для поверхностного монтажа от компании «СмтМакс» на ExpoElectronica-2024..... № 3, с. 104
- С. Исаев, А. Редька.** АО «Микроволновые системы» – 20 лет на службе отечеству..... № 4, с. 48
- М. Кулюкин.** АО «Азимут» – новый шаг в развитии контрактных производств: ориентация на мировой уровень «Индустрии 4.0»..... № 7, с. 80
- Ю. Капшунова, С. Колочков.** «АйСи Сокет» – ваш партнер по разработке измерительной и испытательной оснастки..... № 7, с. 84
- И. Косых.** «МикроЭМ Технологии»: больше, чем технологический партнер..... № 10, с. 62

ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ

- В. Алексеев.** О методических подходах к формированию требований по уровню локализации электронной компонентной базы и других комплектующих в рамках процессов импортозамещения радиоэлектронной продукции..... № 10, с. 66

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

- И. Мандрик, И. Новожилов.** Технологии и оборудование для процессов временного и постоянного бондинга полупроводниковых пластин..... № 7, с. 176
- В. Иванов.** Спреевое нанесение фоторезиста для создания равномерной пленки в полостях..... № 7, с. 182
- А. Витюгов.** Селективная пайка – оптимальное решение для монтажа многослойных теплоемких печатных плат..... № 9, с. 128

ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭЛЕКТРОНИКА И ВСТРАИВАЕМЫЕ СИСТЕМЫ

- А. Медведев.** Компьютерные модули – преимущества применения и популярные стандарты на примерах продукции НПК «АТРОНИК»..... № 3, с. 158
- Ю. Березина.** Волоконно-оптические гироскопы и системы на их основе. Часть 1..... № 3, с. 170

- Ю. Березина.** Волоконно-оптические гироскопы и системы на их основе. Часть 2..... № 4, с. 120
- Д. Аверичев, Ю. Березина.** Опорно-поворотные устройства в различных отраслях промышленности..... № 6, с. 56
- М. Андриянова.** Разъемы USB Type-C..... № 7, с. 140
- Д. Аверичев.** Актуальные приводные решения в робототехнических комплексах..... № 7, с. 144
- А. Бекмачев.** BLITZSensor. Ателье инерциальных датчиков: от высокоточных систем до электросамокатов..... № 10, с. 132

РАДИОТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

- Г. Анцев, В. Сарычев.** Взгляд на перспективы сверхширокополосной твердотельной радиоэлектроники из 2024 года..... № 4, с. 54
- А. Иванцов, М. Фабричный, А. Федоров.** Сверхкороткоимпульсные зондирующие сигналы в системах ближней локации..... № 4, с. 62

РЕПОРТАЖ С ПРЕДПРИЯТИЯ

- Ю. Ковалевский.** 60 лет в микроэлектронике. Визит на кристалльное производство ОАО «Интеграл»..... № 3, с. 86
- Ю. Ковалевский.** Как создаются контрольно-измерительные приборы для СВЧ-электроники: качество, точность и... экономичность. Визит на производство ООО «ПЛАНАР»..... № 4, с. 36
- Ю. Ковалевский.** Новое оборудование – новые возможности для увеличения объема выпуска и качества продукции. Визит на производство ООО «Кулон»..... № 5, с. 48
- Ю. Ковалевский.** Четыре фактора снижения себестоимости продукции на два порядка. Визит на производство ООО «БУТИС»..... № 7, с. 68
- Ю. Ковалевский.** Локализация производства оборудования: от дымоуловителей к уникальным роботизированным комплексам. Визит на производство ООО «Протех»..... № 10, с. 50

СВЧ-ЭЛЕКТРОНИКА

- В. Кочемасов.** СВЧ-переключатели, управляемые по интерфейсам USB, SPI и Ethernet..... № 1, с. 116
- Л. Недашковский, В. Репин.** Методика проектирования пассивных полифазных фильтров..... № 2, с. 108
- Е. Старовойтов, Е. Скиба, Л. Недашковский.** СВЧ-микросхемы для бортовой аппаратуры ДЗЗ и систем космической связи. Часть 1..... № 3, с. 148
- Е. Старовойтов, Е. Скиба, Л. Недашковский.** СВЧ-микросхемы для бортовой аппаратуры ДЗЗ и систем космической связи. Часть 2..... № 4, с. 68
- С. Сковородников, Д. Семенов.** Разработка и моделирование СВЧ-фильтра с контактами типа flip-chip..... № 4, с. 72
- В. Кочемасов, Е. Торина, А. Сафин.** МЭМС-переключатели ВЧ / СВЧ-сигналов. Часть 1..... № 4, с. 76

Статьи и материалы, опубликованные в журнале «ЭЛЕКТРОНИКА: Наука, Технология, Бизнес» в 2024 году

К. Джуринский. Особенности конструирования и технологии изготовления соединителей

мм-диапазона длин волн № 5, с. 80

В. Кочемасов, Е. Торина, А. Сафин.

МЭМС-переключатели ВЧ / СВЧ-сигналов. Часть 2 № 5, с. 86

В. Соляник, А. Мирошниченко. Влияние структуры и свойств тонких пленок осмия на эмиссионную способность и долговечность катода № 5, с. 98

М. Белкин, М. Васильев, Д. Ключник, Е. Кузнецов.

Создание радиофотонной аппаратуры на базе технологий оптической и сверхвысокочастотной электроники № 5, с. 106

В. Кочемасов, Е. Торина, А. Сафин. МЭМС-переключатели ВЧ / СВЧ-сигналов. Часть 3 № 6, с. 88

К. Джуринский, А. Андросов. Эволюция соединителей SMP. Частота 100 ГГц уже не предел № 7, с. 112

Е. Савченко, А. Мартынов, А. Першин, М. Селиванов. Основные подходы к построению схем управления питанием GaN СВЧ-усилителей мощности № 9, с. 96

А. Димаки, О. Кравченко, Г. Кун. Автоматическая подстройка частоты при измерении S-параметров конверторов с помощью векторных анализаторов цепей производства АО «НПФ «Микран» № 10, с. 90

СИЛОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА

А. Воронцов. Источники электропитания постоянного тока с регулируемым значением выходного напряжения № 2, с. 98

Д. Глухов. Высоконадежные модульные источники вторичного электропитания № 6, с. 50

Т. Гайказьян. Обзор линейки источников питания компании SmartPower № 7, с. 146

СИСТЕМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Н. Малышев. Развитие отечественных САПР проектирования микроэлектроники на платформе Delta Design № 1, с. 70

А.В. Строгонов, О. Бордюжа, А.И. Строгонов. Эффективный подход в разработке управляющих автоматов микропроцессорных ядер № 1, с. 78

А. Чеплаков, Э. Литвиненко. Разработка математической модели AMR-преобразователя для внедрения в САПР № 3, с. 180

Е. Плотникова, А. Арсентьев, А. Винокуров. Моделирование солнечного элемента с регулярным рельефом поверхности структуры в САПР технологического уровня № 3, с. 188

А.В. Строгонов, А. Винокуров, А.И. Строгонов. Пример реализации одноконтурного процессорного ядра RISC-V в САПР Altera Quartus II № 9, с. 70

СОБЫТИЕ НОМЕРА

Ю. Ковалевский. Пленарные заседания Российского форума «Микроэлектроника 2024». Часть 1 № 9, с. 38

СРЕДСТВА ОТОБРАЖЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ

А. Павленко. Компания KingTech – новый эксперт в области производства TFT ЖК-дисплеев № 3, с. 176

А. Павленко. Дисплеи для медицинских, измерительных и промышленных приборов производства Powertip № 7, с. 106

А. Павленко. OLED-технологии в медицинском оборудовании № 10, с. 148

СХЕМОТЕХНИКА

С. Михин, О. Кошкур, В. Ганжа, А. Романов. Разработка электронной платы преобразователя температуры точки росы № 5, с. 158

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ

Д. Поцелуев. Флюс-гель «Солиус ФГ-018»: чем паяют российские специалисты № 1, с. 88

Е. Антипова, А. Спиридонова, Н. Короткова, С. Гладких. УФ-отверждаемый клей Элад УФ-50 с ультразвуковой усадкой для монтажа оптических элементов № 1, с. 94

А. Егоров, Е. Данилов, А. Иванов, Е. Гурова, Н. Романов, А. Гареев, Ю. Хрипунова. Разработка диэлектрического теплопроводящего пленочного адгезионного материала для нужд электроники – отечественный опыт № 2, с. 70

Ю. Коваль. «ХимСоник» – ультразвуковые ванны нового поколения № 2, с. 74

И. Рожков, А. Гаранин, Д. Подольский. В погоне за совершенством: от глубоко машинного обучения к искусственному интеллекту в системах оптической инспекции (АОИ) Maker-Ray. Часть 2 № 3, с. 200

Д. Поцелуев. Как ваш pH? Ключевые требования и подходы к выбору жидкостей для отмывки печатных узлов на pH-нейтральной основе № 6, с. 72

А. Фединцева. Жгутовой цех: станок ЧПУ для раскладки проводов и другие передовые разработки № 6, с. 82

С. Дубяга, И. Козырев. Важен каждый атом: применение высокочистых газов в микроэлектронной промышленности № 7, с. 190

В. Тарасик, И. Козловский, Д. Ционенко, А. Лешок. Анализ механических и теплопроводящих свойств керамико-полимерных диэлектрических материалов № 8, с. 94

П. Елисов. Дефицит спецоснастки из кварцевого стекла для планарной технологии в производстве микроэлектроники будет преодолен № 8, с. 102

Д. Корень, А. Гаранин. Системы формовки выводов планарных компонентов № 10, с. 76

А. Иванов. Демонстрационные испытания технологического оборудования и материалов для отмывки печатных плат № 10, с. 82

Статьи и материалы, опубликованные в журнале «ЭЛЕКТРОНИКА: Наука, Технология, Бизнес» в 2024 году

**В. Егошин, Ш. Шугаепов, Р. Ахметгалиев,
Е. Ермолаев, А. Мазуренко, Ю. Чернышева.**

Применение отечественного глинозема глубокой прокатки
для производства металлокерамических корпусов № 10, с. 86

ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА

Я. Левалдс. Анализ тенденций развития рынка
управления цепями поставок № 6, с. 130

ЦИФРОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Ю. Рогозина, Е. Кузнецова. Смена подрядчика
в процессе внедрения 1С:ERP: как минимизировать риски № 3, с. 224

Е. Янов. О проблемах интеграции информационно-
измерительных систем в условиях противодействия
компьютерным атакам № 6, с. 60

Е. Янов. Построение цифрового двойника
производственного процесса на основе информационно-
измерительной системы косвенного контроля вибрации № 7, с. 168

Е. Семенова, М. Смирнова, С. Гейко. Методика
анализа и оценки рисков информационного обмена
с применением информационно-управляющей системы № 8, с. 90

А. Анцев, Е. Янов. Математическая модель
информационно-измерительной системы косвенного
контроля состояния технологических систем № 9, с. 120

**А. Анцев, Д. Барсуков, М. Воротилин, А. Цивенкова,
Е. Янов.** Данные о потребляемой оборудовании мощности
как дополнительный источник информации
для информационно-измерительной системы № 9, с. 124

ЭКОНОМИКА+БИЗНЕС

О. Книга. Развитие рынка химических материалов
для микроэлектроники России: проблемы и перспективы № 1, с. 56

ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ

М. Гурбашков. Модульный привод ХАРЗА® –
новый подход к решению задач № 3, с. 116

Е. Дудоров, Д. Кувшинов. Электродвигатели
для отечественной робототехники и беспилотных аппаратов № 3, с. 122

Ю. Капшунова, С. Колочков. Контактные устройства для тестирования и испытаний ЭКБ –
надежные решения от компании «АйСи Сокет» № 3, с. 128

Р. Гуров, А. Горьков. Перспективные соединители завода
«Электродеталь» № 3, с. 132

А. Воронов. Надежные соединители для широкого спектра
применений от АО «Завод «Копир» № 5, с. 78

Р. Гуров. Соединители производства
АО «Карачевский завод «Электродеталь»
с контактной парой повышенной надежности № 7, с. 138

А. Эрматова. Соединители от АО «ТЕСТПРИБОР» № 9, с. 64

ЭЛЕКТРОНИКА ГРАЖДАНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

А. Юров, В. Полевиков, А. Федина.
Магнитные микросхемы на основе тонкопленочных
магниторезисторов и возможности их использования
в системах управления и автоматики № 7, с. 92

ЭЛЕКТРОННАЯ КОМПОНЕНТНАЯ БАЗА

Ю. Иванов. Современные кварцевые
и рубидиевые генераторы № 1, с. 106

Д. Садеков. Стандартные компоненты
для широкого применения от Youtai Semiconductor № 3, с. 154

В. Савицкий, А. Раскин. Зарубежные и отечественные
многослойные керамические конденсаторы: технологии,
категории качества № 5, с. 56

М. Соколов. Обзор конденсаторов от JV Capacitors № 5, с. 66

А. Павленко. Пассивные компоненты от компании Hottech № 5, с. 74

Д. Садеков. Китайский производитель Shanghai Belling:
обзор продукции промышленного и гражданского назначения № 7, с. 88

И. Семейкин. Силовые и СВЧ-транзисторы
на основе нитрида галлия от АО «НИИЭТ»:
доступные решения и перспективы № 9, с. 56